

CHIPLED

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

LH Q974



Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusetyp:** 0603, farbloser diffuser Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** extrem kleine Bauform 1,6 mm x 0,8 mm x 0,6 mm
- **Wellenlänge:** 645 nm (hyper-rot)
- **Abstrahlwinkel:** extrem breite Abstrahlcharakteristik (160°)
- **Technologie:** GaAlAs
- **optischer Wirkungsgrad:** 3 lm/W
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 4000/Rolle, ø180 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D

Anwendungen

- optischer Indikator
- Flache Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Display)
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
- Spielsachen

Features

- **package:** 0603, colorless diffused resin
- **feature of the device:** extremely small package 1.6 mm x 0.8 mm x 0.6 mm
- **wavelength:** 645 nm (hyper-red)
- **viewing angle:** extremely wide (160°)
- **technology:** GaAlAs
- **optical efficiency:** 3 lm/W
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 4000/reel, ø180 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D

Applications

- optical indicators
- flat backlighting (LCD, cellular phones, switches, displays)
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- toys

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Lichtstärke ^{1) 2) Seite 13} Luminous Intensity ^{1) 2) page 13} $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$		Bestellnummer Ordering Code
		min.	typ.	
		LH Q974-KN	hyper-red	

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet alle Gruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.

Note: The standard shipping format for serial types includes all groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 30 ... + 85	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 85	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 95	°C
Durchlassstrom Forward current ($T_A=25^\circ\text{C}$)	I_F	30	mA
Stoßstrom Surge current $t_p = 10 \mu\text{s}, D = 0.1, T_A=25^\circ\text{C}$	I_{FM}	0.1	A
Sperrspannung ³⁾ Seite 13 Reverse voltage ³⁾ page 13 ($T_A=25^\circ\text{C}$)	V_R	5	V
Leistungsaufnahme Power consumption ($T_A=25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	80	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung ⁴⁾ Seite 13 Junction/ambient ⁴⁾ page 13	$R_{th JA}$	800	K/W
Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point	$R_{th JS}$	450	K/W

Kennwerte
Characteristics
 $(T_A = 25\text{ °C})$

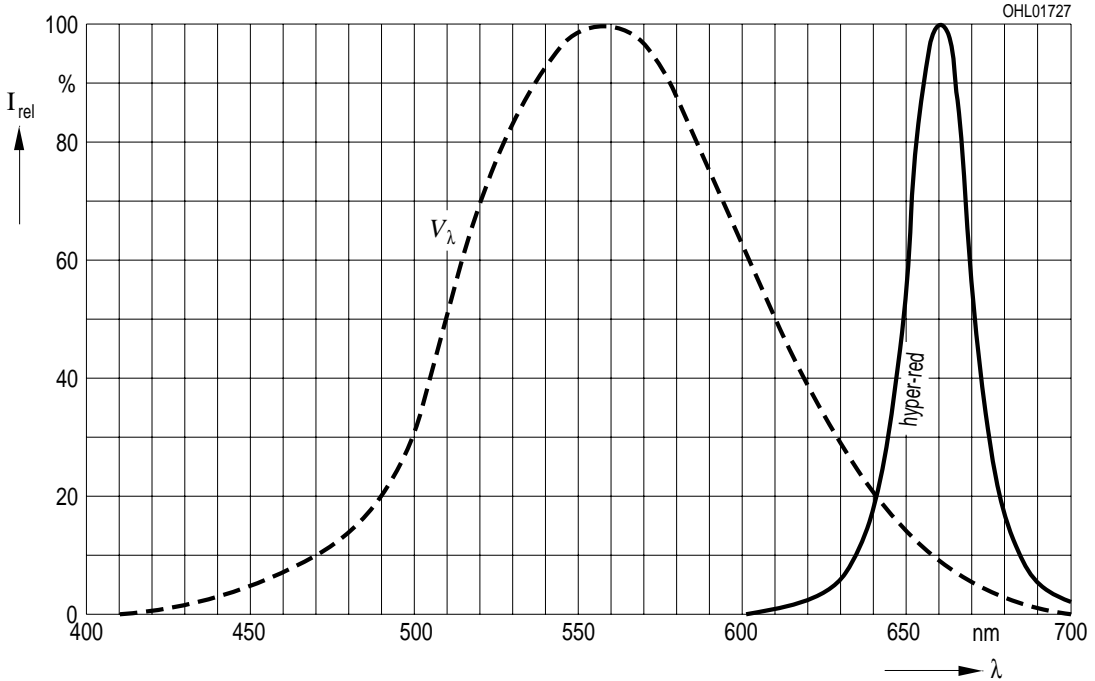
Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) λ_{peak}	660	nm
Dominantwellenlänge ^{5) Seite 13} Dominant wavelength ^{5) page 13} $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) λ_{dom}	643	nm
Spektrale Bandbreite Spectral bandwidth $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\Delta\lambda$	20	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	(typ.) 2φ	160	Grad deg.
Durchlassspannung ^{6) Seite 13} Forward voltage ^{6) page 13} $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) V_F (max.) V_F	1.8 2.5	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5\text{ V}$	(typ.) I_R (max.) I_R	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.18	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.06	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F Temperature coefficient of V_F $I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.) TC_V	-1.7	mV/K
Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) η_{opt}	3	lm/W

Relative spektrale Emission^{2) Seite 13}

Relative Spectral Emission^{2) page 13}

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

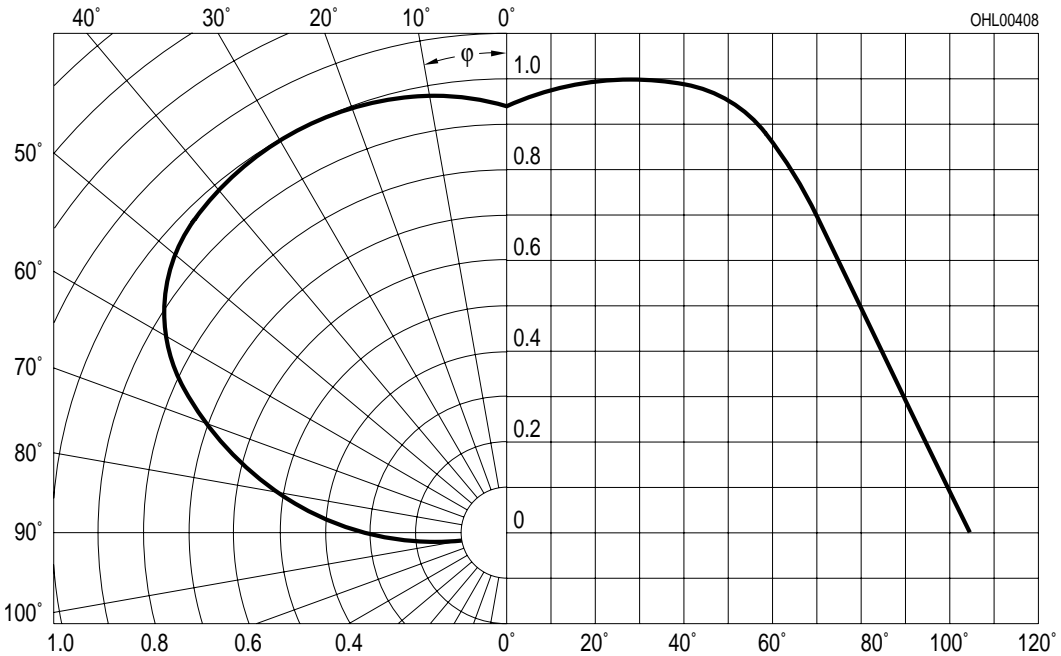
$I_{rel} = f(\lambda); T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}; I_F = 20\text{ mA}$



Abstrahlcharakteristik^{2) Seite 13}

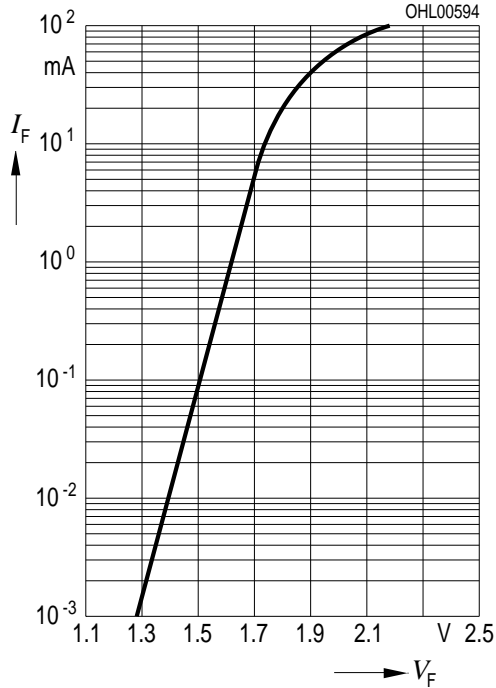
Radiation Characteristic^{2) page 13}

$I_{rel} = f(\varphi); T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$



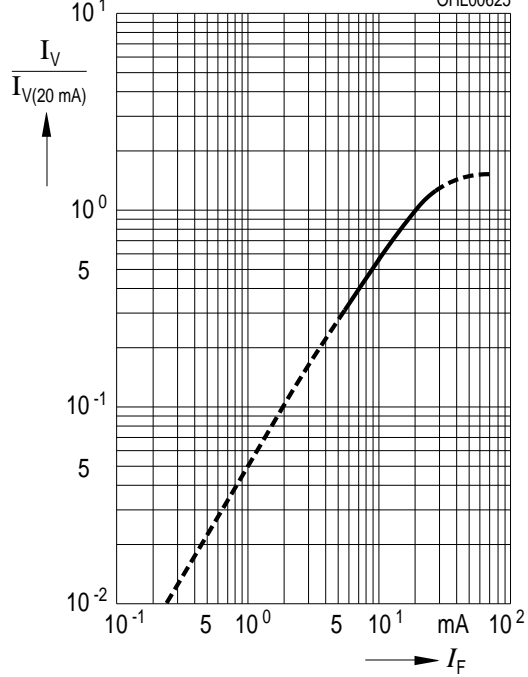
Durchlassstrom^{2) Seite 13}
Forward Current^{2) page 13}

$I_F = f(V_F); T_A = 25\text{ °C}$



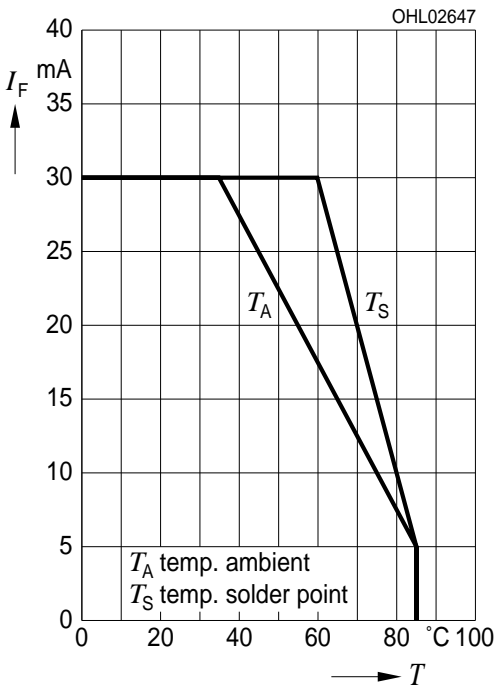
Relative Lichtstärke^{2) 7) Seite 13}
Relative Luminous Intensity^{2) 7) page 13}

$I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F); T_A = 25\text{ °C}$



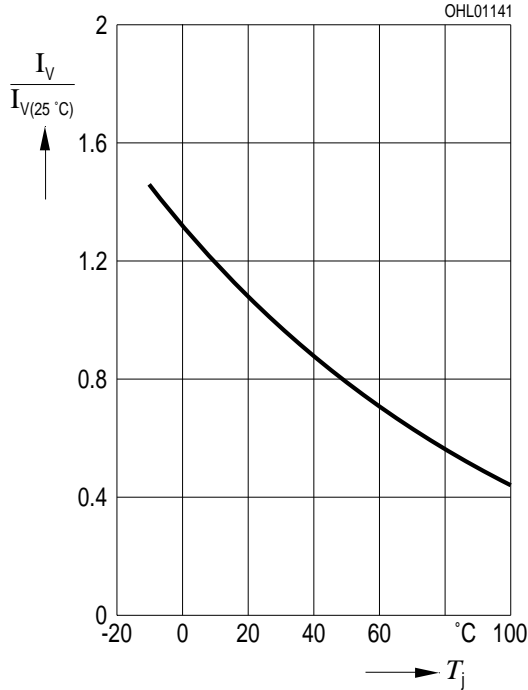
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current

$I_F = f(T)$

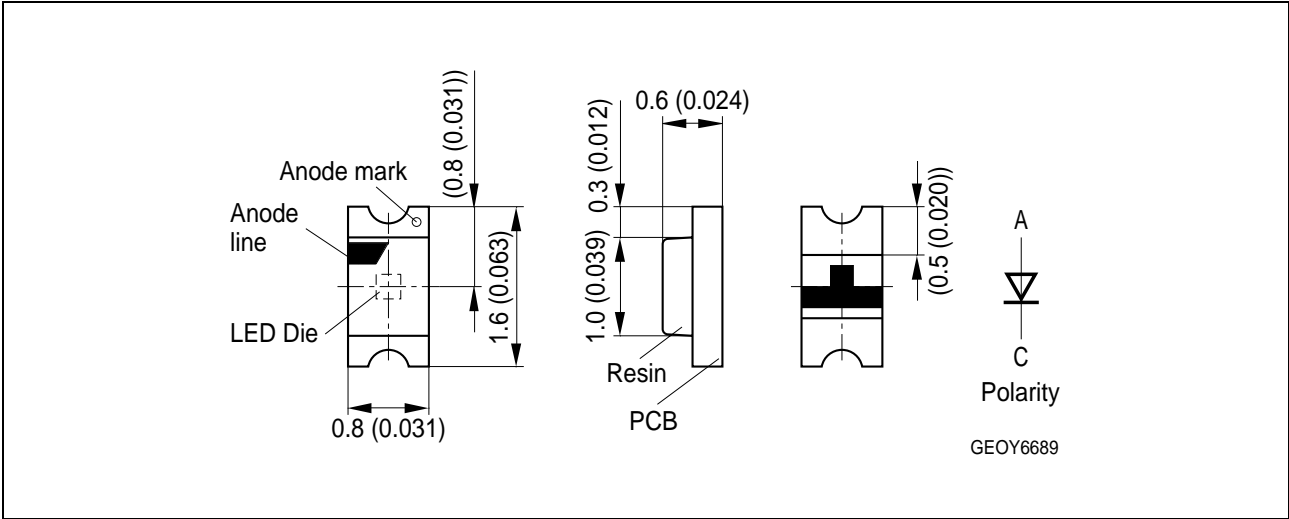


Relative Lichtstärke^{2) Seite 13}
Relative Luminous Intensity^{2) page 13}

$I_V/I_{V(25\text{ °C})} = f(T_A); I_F = 20\text{ mA}$

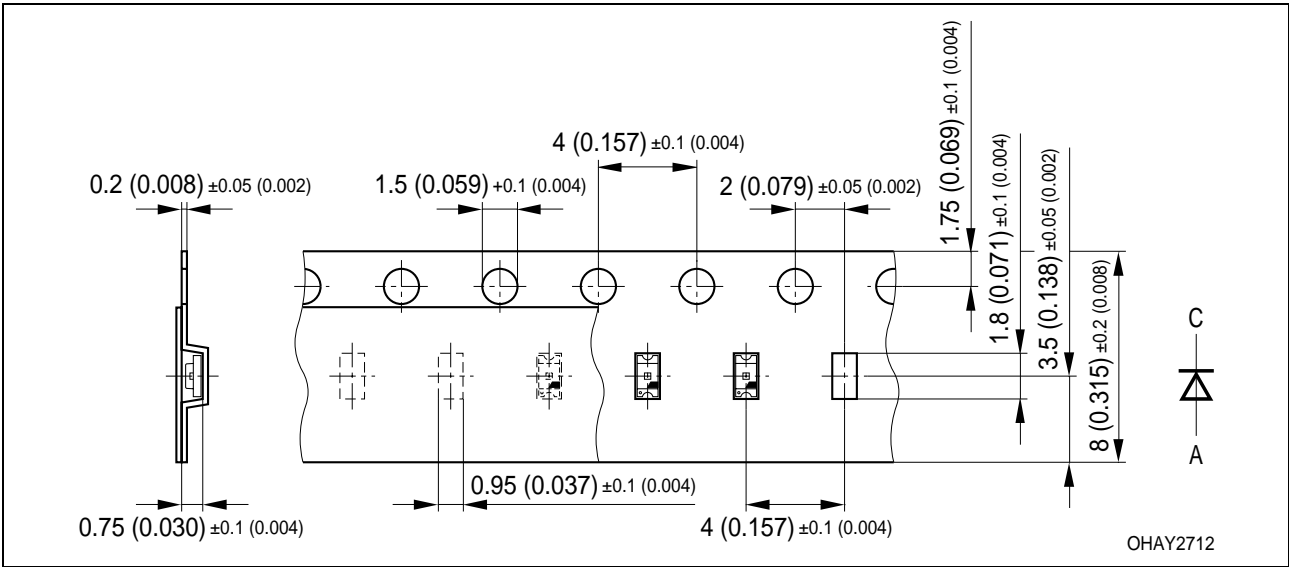


Maßzeichnung⁸⁾ Seite 13
Package Outlines⁸⁾ page 13



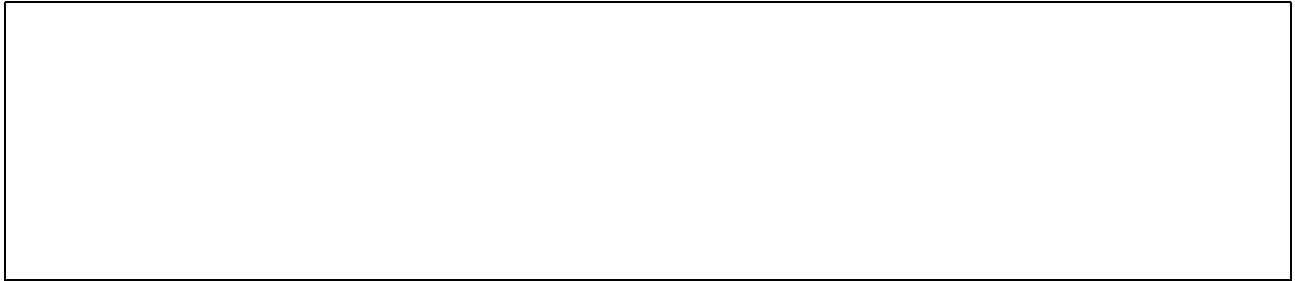
Gewicht / Approx. weight: 3.2 mg

Gurtung / Polarität und Lage⁸⁾ Seite 13 Verpackungseinheit: 4 Rollen mit 4000/Rolle, 8 mm Gurt, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation⁸⁾ page 13 Packing unit: 4 reels with 4000/reel, 8 mm tape, ø180 mm

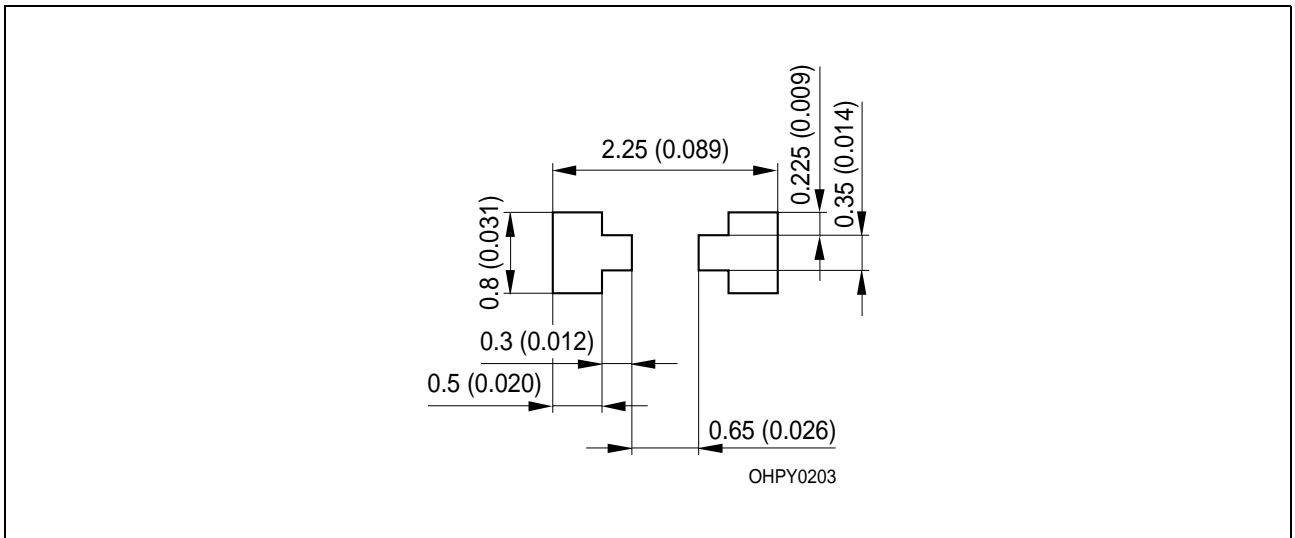


Empfohlenes Lötpad Design⁸⁾ Seite 13
Recommended Solder Pad⁸⁾ page 13

IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering



Empfohlenes Lötpad Design verwendbar für CHIPLLED und Chiplid - Bauform 0603^{8) 9)} Seite 13
IR Reflow Löten
Recommended Solder Pad useable for CHIPLLED and Chiplid Package 0603^{8) 9)} page 13
IR Reflow Soldering

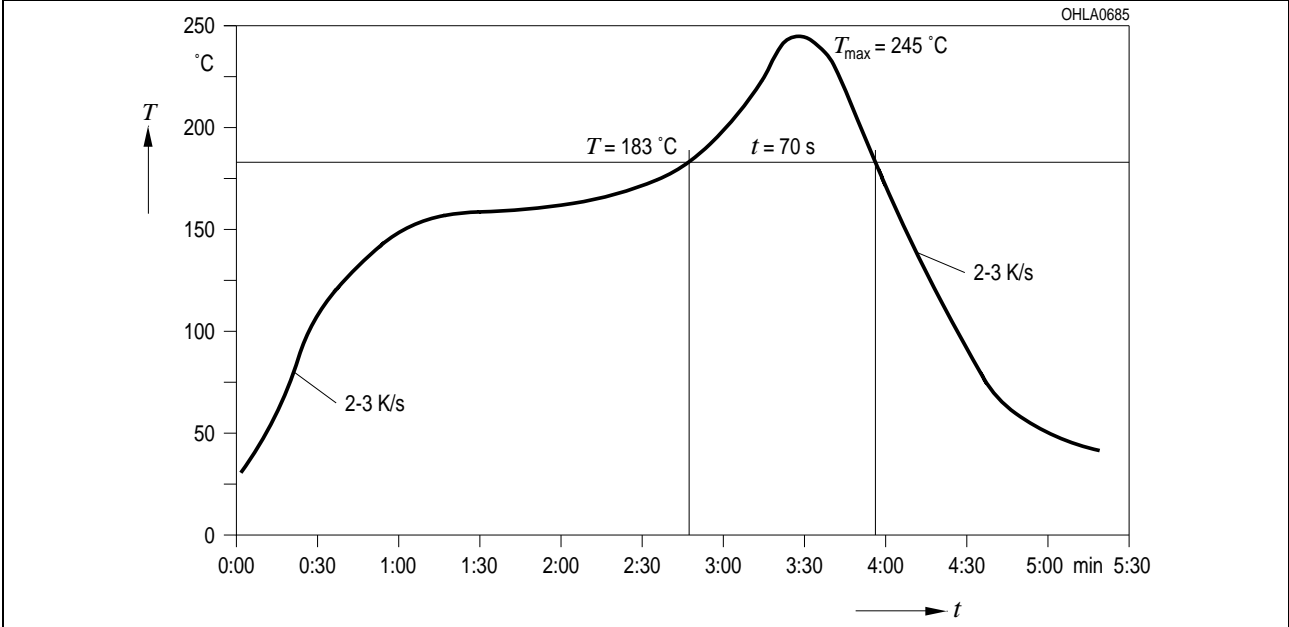


Lötbedingungen
Soldering Conditions

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

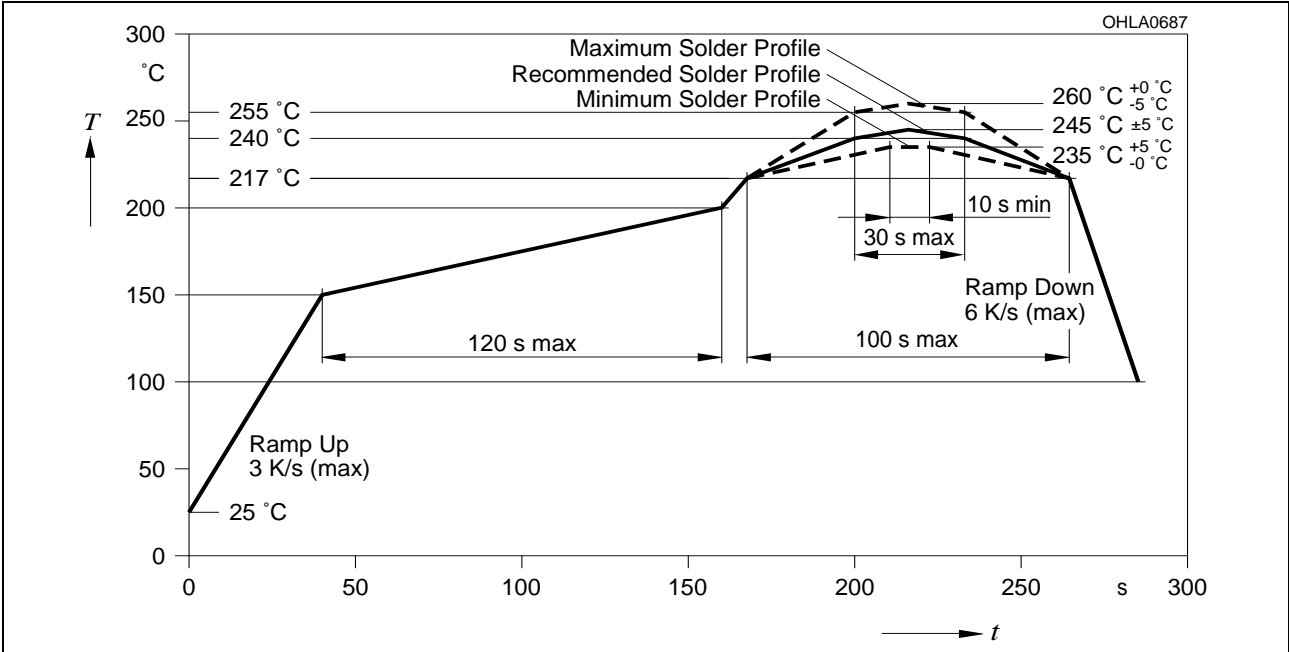
IR-Reflow Lötprofil
IR Reflow Soldering Profile

(nach CECC 00802)
 (acc. to CECC 00802)



IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering

(nach J-STD-020B)
 (acc. to J-STD-020B)



Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)

OSRAM Opto Semiconductors

Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
 Product Name Bin2:
 Bin3:

(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code

RoHS Compliant ML Temp ST
 2 260 C RT

(1T) LOT NO: Lot Number (9D) D/C: Date Code
Bar Code

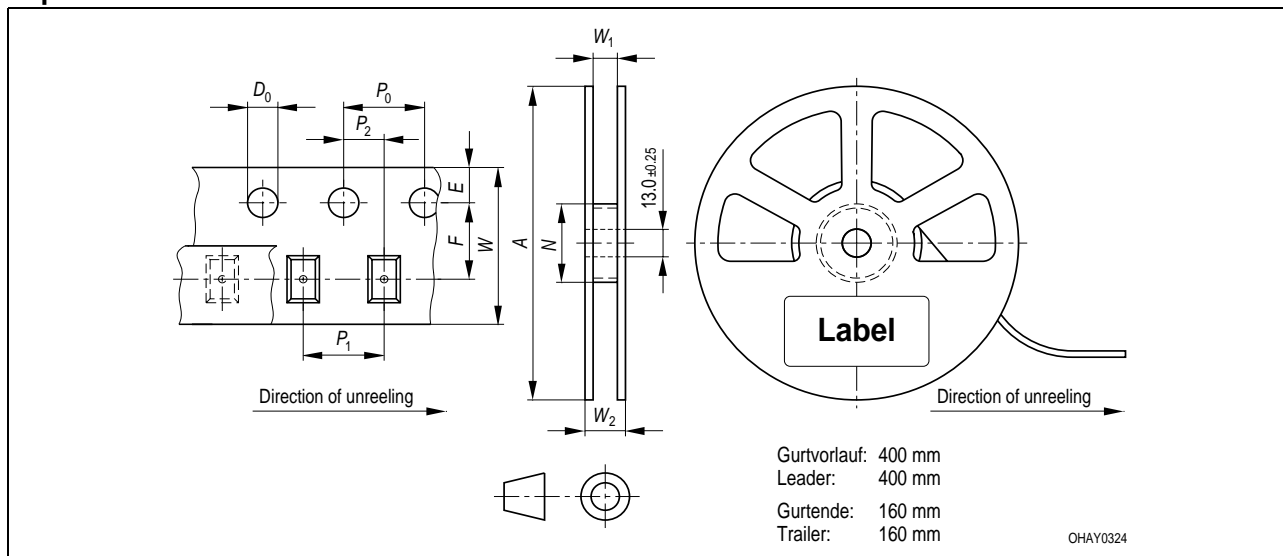
Additional TEXT
 R077 DEMY
 PACKVAR: Packing Type

(X) PROD NO: Product Code (Q) QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: X - X - X
Bar Code

Forward Voltage Group
 Wavelength Group
 Brightness Group

OHA12043

Gurtverpackung
Tape and Reel



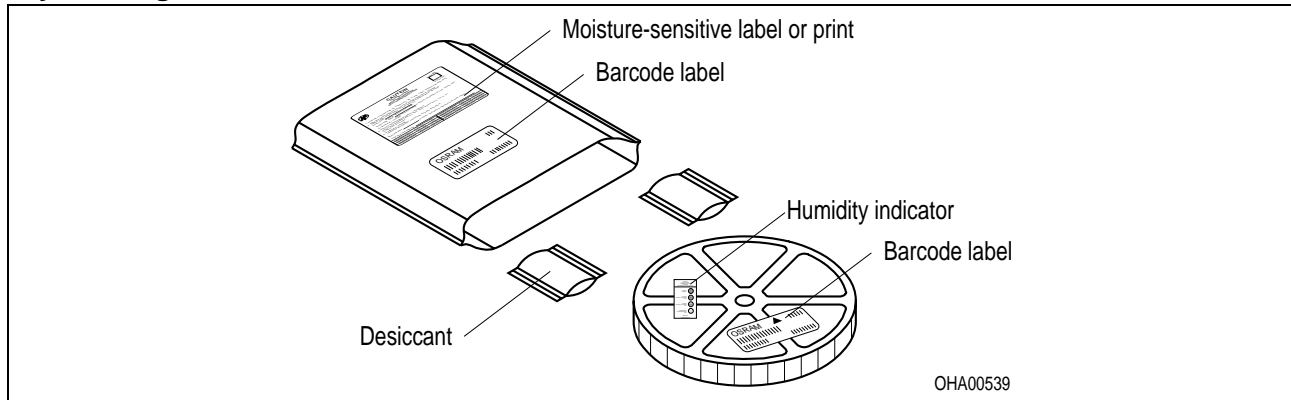
Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
8 + 0.3 - 0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	3.5 ± 0.05 (0.138 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2 max}
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)

Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials



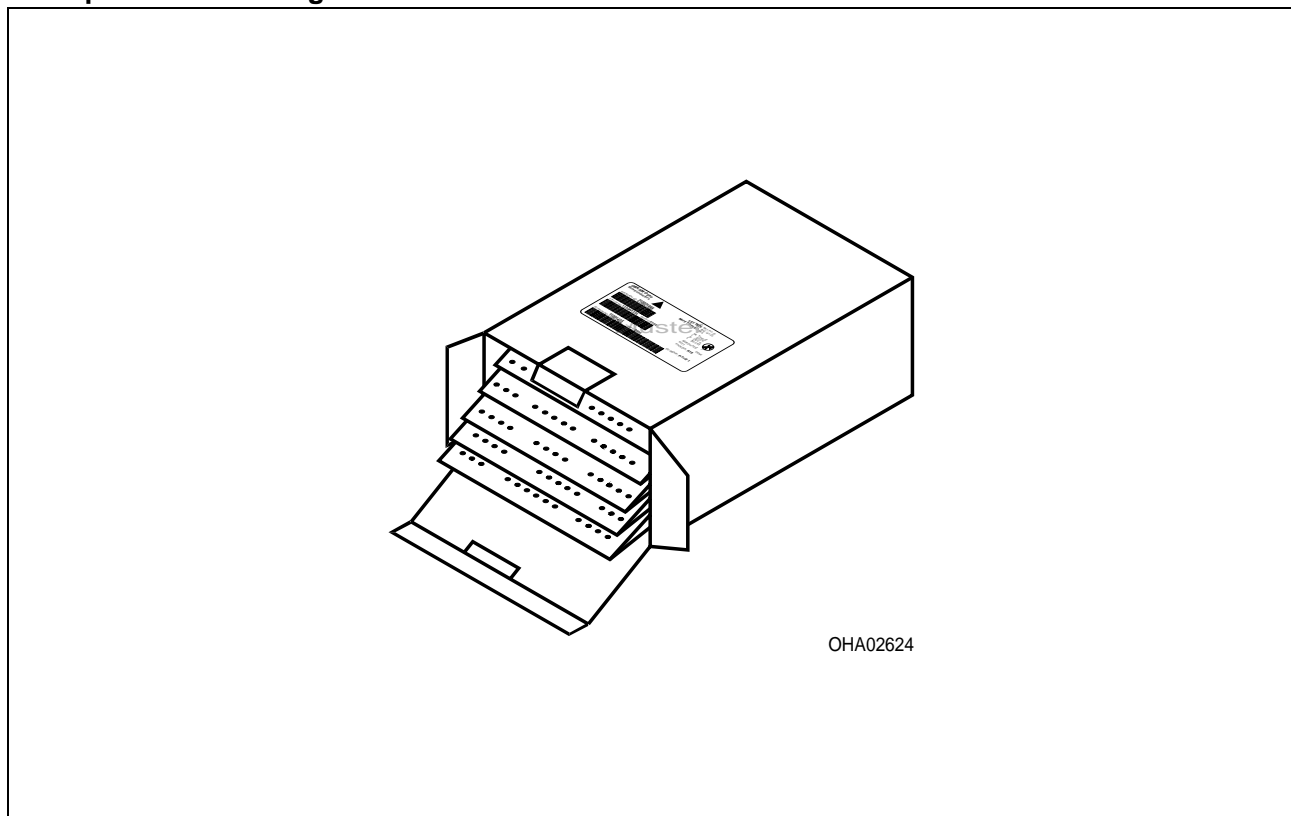
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.

Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials



Revision History: 2009-06-15

Previous Version: 2005-12-22

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
2	Ordering Information	2005-12-22
2	correction of ordering code	2009-06-15

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components^{10) page 13} may only be used in life-support devices or systems^{11) page 13} with the express written approval of OSRAM OS.

2009-06-15

12

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 4) Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 5 \text{ mm}^2$)
- 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1 \text{ nm}$ ermittelt.
- 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1 \text{ V}$ ermittelt.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 9) Empfohlene Lötpastendicke: 120 μm
- 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
 - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
 - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 4) Mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 5 \text{ mm}^2$)
- 5) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1 \text{ nm}$.
- 6) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1 \text{ V}$.
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 9) Recommended thickness of solder paste: 120 μm
- 10) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 11) Life support devices or systems are intended
 - (a) to be implanted in the human body,
 - or
 - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
 Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
 © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。